



DISCO

2022년 8월 25일

고객사 각위

주식회사 디스코

품질보증부 부장 키시나미 코이치



### 폐사제품에 관한 주의사항 : 제삼자에 의한 허브블레이드의 재생처리에 관하여

평소 폐사 제품에 대한 각별한 배려에 깊은 감사를 드립니다.

최근 폐사와 전혀 관계없는 업자(이하 "제삼자")가 폐사의 허브블레이드에 대해 재생처리 (블레이드 날끝의 노출부분의 재생)를 위탁받고 있는 것을 확인 하였습니다.

제삼자는, 재생처리 프로세스가 폐사의 허브블레이드의 제조프로세스와 동등한 것처럼 설명하는 경우도 있다고 합니다. 하지만 폐사의 허브블레이드의 제조프로세스는 완전비공개인 관계로 제삼자가 폐사와 동등한 제조프로세스를 실시한다고 생각하긴 어려우며, 제삼자에 의한 재생처리는 폐사 제조프로세스와 다르다고 판단하고 있습니다.

제삼자에 의한 폐사 허브블레이드의 재생품(이하 "재생처리 블레이드")에 관하여, 폐사는 기술 및 제조, 품질관리등 일절 관여하고 있지 않습니다. 그러므로 재생처리 블레이드는 폐사제품과 무관한 별도의 제품으로 간주하며, 사용시에는 다시 최종사용자의 인증취득 등의 작업이 필요하리라 생각합니다.

고객사의 변경관리에 저촉될 우려도 있으며 또한 가공품질에도 영향을 줄 수 있기 때문에, 재생처리 블레이드의 사용은 큰 리스크를 동반한다는 것을 인식할 필요가 있음을 알려드립니다.

재생처리 블레이드의 사용에서 비롯된 불합리사항에 대한 대응에 있어, 현품조사 등을 포함하여 전부 폐사 보증범위 에서 제외됩니다. 재생처리 블레이드의 사용에 기인하여 발생한 제반 손해에 대해서도 폐사는 일절 책임을 질 수 없음을 양해 바랍니다.

#### 재생처리 블레이드 사용에 대한 리스크

- 피가공물의 칩핑(chipping)
- 블레이드의 파손
- 블레이드의 사형(meandering)
- 커프폭(kerf width)의 넓어짐 등

예 : Si 웨이퍼의 칩핑 비교



폐사 출하시의 허브블레이드의 가공상태

재생처리된 허브블레이드의 가공상태

이상

개정이력

개정이력	발행일	개정내용
초판	2018년 12월 28일	—
제 2 판	2022년 8월 25일	품질보증부 부장 이름 변경